



Orbotech Nuvogo™ 80F/80FXL

量產細線路直接成像



Orbotech Nuvogo 80F/80FXL

Orbotech Nuvogo 80F/80FXL 是一款量產直接成像解決方案，專為優化 HDI, 軟板和軟硬結合板應用而設計。Orbotech Nuvogo 80F/80FXL 採用了 KLA 經業界驗證的 LSO™(大鏡面掃描)技術，MultiWave Laser™ (多波長雷射) 技術和先進的漲縮演算法，確保最好的成作品質及精確度。Orbotech Nuvogo 80F/80FXL 實現了高產量，連線產能高達每天 7,000 片板子，在保持高速、最佳品質的同時，降低了總體擁有成本 (TCO)。



優勢

量產數位成像

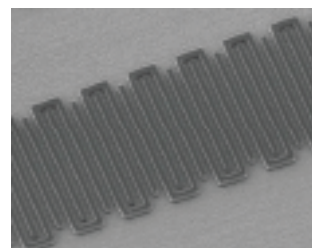
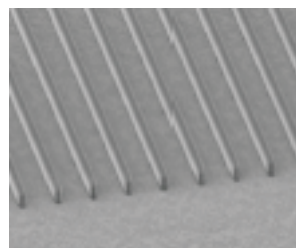
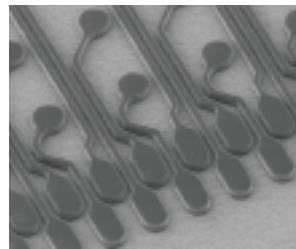
- 高產量: 連線產能高達每天 7,000 片板子
- 高效率的快速靶點捕捉
- 採用雙檯面傳輸機製，實現最佳化的成像時間

高成作品質

- 獨一無二的光學設計帶來最優線條結構，低至 15 μm 線寬/間距
- 高景深，能克服具有挑戰性的表面高低變化
- 先進的漲縮模式，可實現出色對位精度 ($\pm 10 \mu\text{m}$)

高效率

- 兼容多樣的感光膜和製程
- 高效料號列隊管理，實現最大生產效率
- 配備自動化解決方案可實現無縫連接生產



細小線寬/間距低至 15/15 μm

Technologies

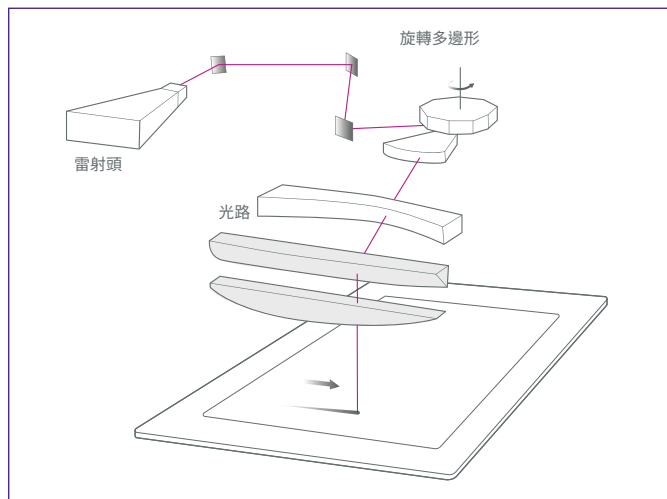


LSO™ Technology



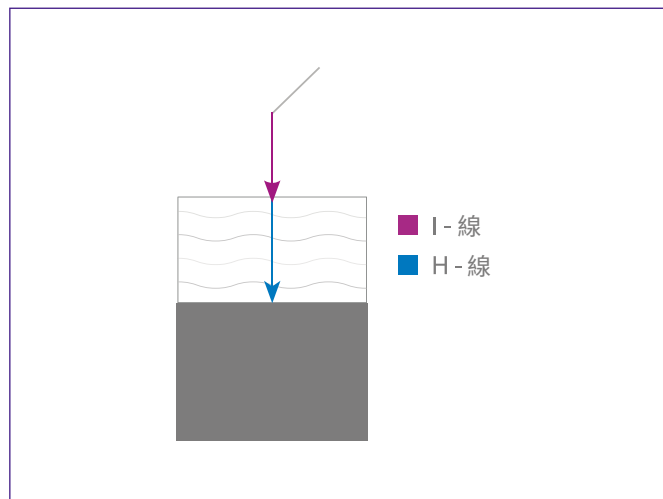
MultiWave Laser™ Technology

高成像品質

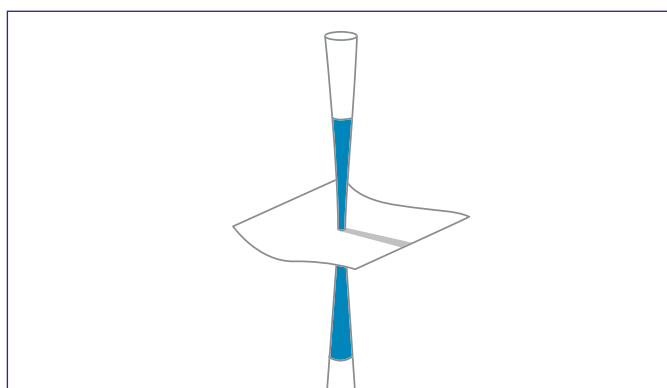


採用 KLA 的 LSO™ (大鏡面掃描) 技術，單次掃描即可實現卓越的線條結構

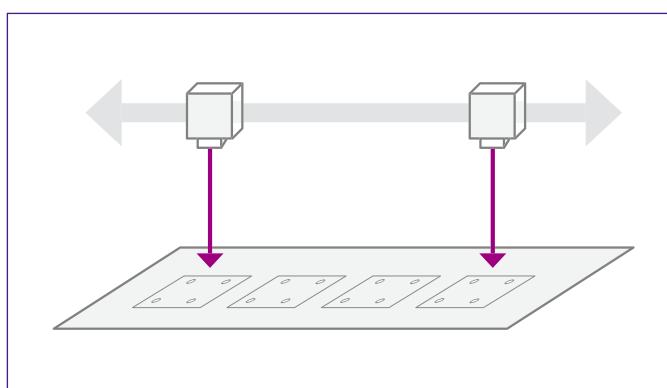
支持多種感光膜



採用 KLA 的 MultiWave Laser™ (多波長雷射) 技術，兼容多種感光膜和製程



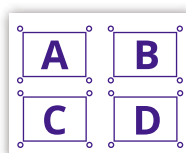
高景深 (DOF) 能克服具有挑戰性的表面高低變化



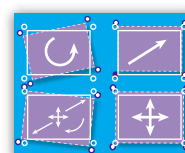
動態靶點識別和捕捉

先進的漲縮模式

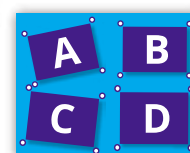
- 智慧漲縮-最佳量產漲縮模式，同批次板件達到最高的一致性
- 自動漲縮/固定漲縮/群組漲縮
- 分割漲縮—超薄內層分區對位
- 極速靶點捕捉，降低產能損失



CAM 數據



板子



圖像

可追溯性

通過動態標記進行板子追蹤：序號標識；小排版和 PCB；日期與時間標識；漲縮標識和由字母數位組成的設備 ID，一維條碼或二維條碼 (Data Matrix Code)。

系統規格

	Orbotech Nuvogo 80F	Orbotech Nuvogo 80FXL
最大產能*	每小時 300 面 成像尺寸 24"x18"	每小時 290 面 成像尺寸 25"x18"
最小線寬/間距*	15/15µm	
解析度	1.5µm	
對位精度 FtG**	±10µm	
層間對位精度 FtB**	20µm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm 25" x 26"	660mm x 812mm 26" x 32"
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm 24" x 26"	635mm x 812mm 25" x 32"
基板厚度	0.025mm - 8mm	
成像能量範圍	10 - 2,200mj/cm ²	

*取決於感光膜特性和製程

** 所有值均為 3σ

以上產品規格如有變更恕不另行通知

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation

www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 4.0_3-29-2022

© 2022 KLA 公司。所有品牌或產品名稱可能為其各自公司的商標。KLA 保留在不另行通知的情況下更改硬體和/或軟體規格的權利。